課題番号	:F-19-NU-0086
利用形態	:機器利用
利用課題名(日本語)	:スパッタリング収率の結晶方位依存性
Program Title (English)	:Crystallographic orientation dependence of the sputtering yields
利用者名(日本語)	:長崎正雅,山本修平
Username (English)	: <u>T. Nagasaki</u> , S. Yamamoto
所属名(日本語)	:名古屋大学大学院工学研究科
Affiliation (English)	:Graduate School of Engineering, Nagoya University
キーワード/Keyword	:膜加工・エッチング、形状・形態観察、スパッタリング,結晶方位、二体衝突近似

<u>1. 概要(Summary)</u>

スパッタリングの収率は、ターゲットの結晶方位によって 異なることが知られている。しかし、両者の定量的な関係 は、十分明らかになっていない。本研究では、金属多結 晶試料をイオンビームでスパッタし、スパッタクレータ深さ マッピングと結晶方位マッピングを行うことで、両者の関係 を明らかにすることをめざしている。今年度は、特に体心 立方構造の金属について、入射イオンエネルギーの影響 に注目して実験を進めた。

<u>2. 実験(Experimental)</u>

【利用した主な装置】

デジタルマイクロスコープ一式

【実験方法】

Fe および Mo の多結晶試料を鏡面研磨し、試料表面 に垂直な方向から 4 keV または 1 keV の Ar イオンビー ムでスパッタした。この試料に対して、共焦点レーザー顕 微鏡あるいは白色干渉顕微鏡を用いてスパッタクレータ の深さマッピングを行った。また、同一試料に対して、電 子線後方散乱回折法(EBSD)を用いて結晶方位マッピ ングを行った。得られたクレータ深さマップと結晶方位マッ プを対応づけることにより、スパッタ収率と結晶方位の関 係を求めた。さらに、二体衝突近似シミュレーションコード を用いて、結晶中における入射イオンの挙動を調べた。

<u>3. 結果と考察(Results and Discussion)</u>

Fig. 1 は、Mo に対するスパッタ収率を、逆極点図上に 等高線表示したものである。 4 keV の場合、逆極点図の 111,001 付近および 111→001,111→101 沿いでスパッ タ収率が小さい。すなわち、Ar+が(111)、(001)軸あるい は{110}面に平行に入射するとスパッタ収率が小さい。シ ミュレーションではこれらの方位でチャネリングが起きてお り、スパッタ収率の結晶方位依存性がチャネリング確率の 結晶方位依存性に支配されていることを示している。一方 1 keV の場合は、スパッタ収率の最大値と最小値の比が 小さい上に、111→001, 111→101 沿いの収率の「谷」が ほとんど見られない。これは、入射エネルギーの低下に伴 いチャネリングが起こりにくくなったためと考えられる。ただ し、シミュレーション結果を見ると、1 keV のイオンをチャネ リングあり/なしに二分するのはむずかしい(チャネリング 確率が定義しにくい)。そこで、入射イオンが試料表面近 傍 20 Åまでに付与するエネルギーを評価したところ、スパ ッタ収率との間に非常によい相関があることがわかった。



Fig. 1 Crystallographic orientation dependence of the sputtering yield of Mo for 4 and 1 keV Ar⁺.

<u>4. その他・特記事項(Others)</u> なし。

<u>5. 論文·学会発表(Publication/Presentation)</u>

(1)山本修平,長崎正雅,吉野正人,山田智明,第80回
応用物理学会秋季学術講演会20a-E203-1(2019年9月18-21日).

6. 関連特許(Patent)